

证券代码：002669

证券简称：康达新材

康达新材料（集团）股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-005

投资者关系活动类别	■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 _____
参与单位名称及人员姓名	中金公司：傅锴铭、徐啸天。
时间	2025 年 6 月 30 日 10:00—11:00
地点	上海市浦东新区五星路 707 弄御河企业公馆 A 区 3 号楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：沈一涛
投资者关系活动主要内容介绍	董事会秘书沈一涛对公司业务情况进行了详细介绍，并对胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大业务板块的战略发展方向进行了简述。 Q1:请介绍一下公司在风电领域的发展情况？ A: 在风电叶片制造领域，公司围绕风电叶片结构胶核心业务持续深耕，国内市场份额第一地位稳固。作为胶粘剂板块营收的重要构成部分，公司已构建起涵盖风电结构胶、环氧灌注树脂等产品的风电叶片材料供应体系。2024 年，风电结构胶全年销量达 4 万吨；风电环氧灌注树脂全年销量 4.5 万吨，同比增幅超 90%，连续三年实现销量增长。作为国内较早推出超低温手糊树脂的企业，相关产品已通过金风科技认证，并为中材科技、东方电气等行业客户提供配套服务。2025 年一季度，风电结构胶销售量继续保持市占率领先地位。 今年是“十四五”规划收官之年，风电作为清洁能源的重要组成部分，发展趋势向好，特别是风电叶片系列产品业务，规模效应逐渐显现，公司也将积极把握市场机遇，保持产品销量增长趋势。 Q2: 请介绍一下公司签署收购意向协议的标的公司？ A: 成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”）是一家专业

	从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线，包括微控制器芯片 MCU 和 SOC（32 位微型控制器电路、16 位微控制器电路、8 位微控制器电路等）、系统级 SIP 芯片（射频综合控制 SIP 芯片、数据处理模块、异构处理器 SIP 芯片）、各类模拟集成电路（电源管理、接口电路、信号链电路等）以及电路模块等系列产品，尤其在特种装备 MCU 国产替代细分领域具有技术优势和市场影响力。中科华微被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获评四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心，相关领域资质齐全。 中科华微以微控制器（MCU）、高功率密度电源和系统级封装电路（SiP）为核心，并拓展外围电路，形成完整的国产化解决方案，为客户提供增值与服务。中科华微在现有产品优势和市场规模的基础上，未来将进一步扩大完善产品谱系，围绕国家和客户需要，塑造数字电路和模拟电路双轮驱动的业务格局，服务特种装备领域快速发展的技术需求。 Q3：请介绍一下意向收购中科华微的目的？ A：公司在“新材料+电子科技”的战略驱动下有序布局，拟通过本次收购实现在半导体集成电路领域的拓展，纳入特种集成电路设计与检测领域的优质资产，形成新的利润增长点，提升公司盈利能力和持续经营能力。 作为国有控股企业，公司将以现有半导体材料产业（包括 CMP 抛光液、溅射靶材、陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。公司以突破关键领域“卡脖子”问题、填补国内空白为己任，立足“硬科技”，依托前期布局，着力构建涵盖集成电路设计、制造（含 IC、功率半导体 IGBT 芯片及器件等）及封装测试的产业链条。 Q4：请介绍一下公司子公司赛英科技的主营产品及应用领域？ A：赛英科技专业从事嵌入式微波混合集成电路、微波混合集成电路及雷达相关整机、系统产品的开发设计、生产、销售与服务。赛英科技致力于将微波技术与数字技术进行结合，以科研、生产整机雷达、微波组件、专用仪器仪表、海洋通讯产品为主营业务，主要客户为国内配套企业和科研院所等机构，配套产品范围主要为特种装备领域。随着新技术、新产品在不同领域的拓展，业务也从传统的特殊装备领域向民用领域进行部分转化。
--	---

	赛英科技具有全息凝视安防雷达、全息凝视对空警戒雷达等产品的技术储备，其自主研发的“4D 全息凝视雷达”产品主要用于侦测“低慢小”飞行目标。用于“低慢小”飞行器探测的雷达一般称为低空警戒雷达，其具备全天候全天时工作能力，适应夜晚、雨雪、雾霾、扬尘等环境，可应用于边境、机场、军事基地等重点区域内无人机的探测、警戒和目标指示，能够准确的给出目标的航迹信息。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 6 月 30 日